

お客様各位



2007年12月吉日

## 『第9回半導体パッケージング技術展』出展のご案内

拝啓 向寒の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、このたび東京ビックサイトにおきまして展示会『第9回半導体パッケージング技術展』が開催されます。

弊社も昨年に引き続き出展することになりました。

皆さまのご期待に添うべく新たに開発しました機種を展示し、ご紹介ご案内申しあげる所存です。ご多用の折とは存じますが、皆さまお誘いのうえ、ご来場くださいますようご案内申し上げます。

敬具

### 記

会期：2008年1月16日(水)～17日(木)10:00～18:00  
18日(金)10:00～17:00

会場：東京ビックサイト 東展示棟2ホール

小間番号：13-39

出展品目： 卓上型 微小半田ボール/フラックス搭載機(0.1ボール対応機)  
電動検査テーブル  
高速カラーボール選別機(0.1sec/個)  
卓上型四軸ロボット(X,Y,Z, )  
その他



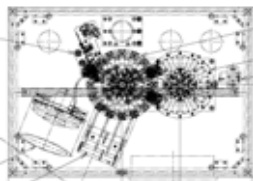
新製品

ICパッケージのP試作、研究開発および少量多品種生産向けに開発しました。簡単な搭載パターン設定とテリングにより任意の位置にフラックスを塗布し、0.1、0.2mm半田ボールを搭載可能です。



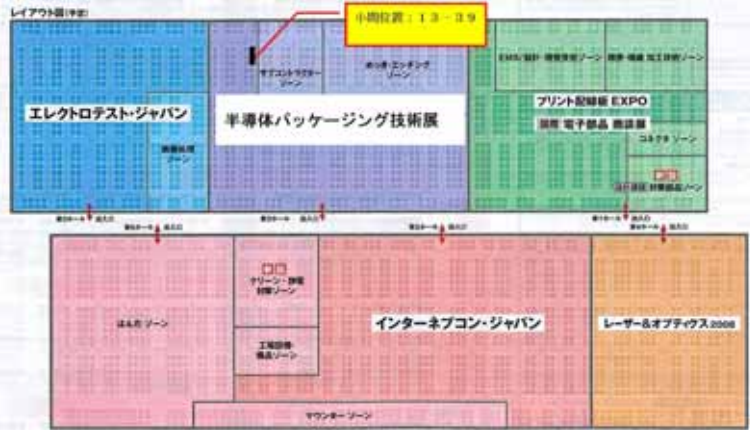
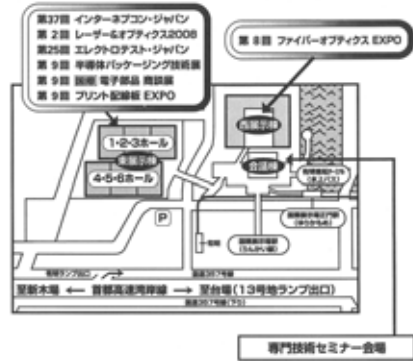
新製品

1. トレー上に並べた基板、フレキシブル、フェールなど微細部品の連続外観検査に最適
2. 検査用カメラを下面からの取付により、部品の底面検査が可能
3. 専用アタッチメントの製作取付により活用範囲が拡大
4. 多品種検査が可能な簡単パターン入力



新製品

1. インテックステブルでの0.1sec/個の高速判別を実現
2. 高速制御ボード(新製品)でコントロール
3. 外観検査、マスキング、プロービングなどでのインテック接続が可能



なお、当日は同封の招待券を必ずお持ちください。お持ちいただかない場合は、有料(¥5,000)となりますのでご注意ください。追加の招待券が必要な場合は弊社までご連絡ください。至急送付させていただきます(営業グループ：藤原)。

マルゴ工業株式会社  
 〒394-0081 長野県岡谷市長地権現町 4-10-6  
 TEL : 0266-28-1211 FAX : 0266-28-1295  
 URL <http://www.mrg.co.jp> E-mail [info@mrg.co.jp](mailto:info@mrg.co.jp)  
 担当者 山岡 俊 幸

**返送先：FAX 0266-28-1295**

担当者が弊社ブースでお待ちしております。当日は技術打合せ、見積り相談ができる技術スタッフがおりますので、ご都合の良い時間をご記入ご連絡お願いいたします。

### アポイントメント表

貴社名 \_\_\_\_\_ TEL \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_

ご芳名 \_\_\_\_\_ 役職 \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

その他連絡事項：

**ご来場予定時間：1月 日 時頃**